公司代码:688512 公司简称:慧智微

广州慧智微电子股份有限公司

2025 年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营中可能存在的相关风险，具体内容详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”的相关内容。敬请投资者予以关注，注意投资风险。

3、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

√是 □否

公司采用《上海证券交易所科创板股票上市规则》2.1.2 条第（二）项的标准上市，上市时尚未盈利。报告期内，公司实现归属于母公司所有者的净利润-22,901.49万元，尚未实现盈利，公司亏损的主要原因系国内射频前端行业国产替代进程加快，行业竞争日趋激烈，产品价格持续承压，毛利空间未能完全释放；同时公司正处于快速增长阶段，为布局新一代前沿通信技术仍需要持续进行研发投入，叠加成本规模效应尚未充分显现。因此，公司尚未达到盈亏平衡。

公司紧跟射频方案高集成化、高端化演进趋势推进产品迭代，不断完善射频前端产品布局，尽管目前尚未实现盈利，但经营质量已显著改善，营收规模大幅增长且亏损持续收窄，核心高端产品实现量产出货，国内外头部客户拓展稳步推进并持续深化合作，为扩大营收规模、提升盈利能力奠定了坚实基础。未来公司将持续提高研发效率，优化产品结构和成本管控，进一步改善毛利水平，努力提升经营水平，以期尽快实现盈利，回报广大投资者。

7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司于2026年4月28日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，由于2025年12月31日母公司财务报表未分配利润为负数，尚不满足利润分配条件，且为保障公司正常生产经营和未来发展需要，公司拟定2025年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

本次利润分配预案尚需经股东会审议批准。

8、是否存在未弥补亏损

√适用 □不适用

截至报告期末，公司母公司财务报表中未分配利润为-91,849.36万元，存在未弥补亏损。根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规的规定，公司目前不满足实施现金分红的前提条件。敬请广大投资者注意相关投资风险。未来公司将继续做好经营管理，改善经营业绩。

9、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	慧智微	688512	不适用

1.2公司存托凭证简况

□适用 √不适用

1.3联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐斌	朱晓磊
联系地址	广州市黄埔区开创大道1566号11层	广州市黄埔区开创大道1566号11层
电话	020-82258480	020-82258480
传真	020-82258993	020-82258993
电子信箱	db@smartermicro.com	db@smartermicro.com

2、报告期公司主要业务简介

2.1主要业务、主要产品或服务情况

1、主营业务的基本情况

慧智微是一家为智能手机、物联网等领域提供射频前端芯片的设计公司，主营业务为射频前端芯片及模组的研发、设计和销售。公司具备全套射频前端芯片设计能力和集成化模组研发能力，技术体系以功率放大器（PA）的设计能力为核心，兼具低噪声放大器（LNA）、射频开关（Switch）、集成无源器件滤波器（IPD Filter）等射频器件的设计能力，同时具备高集成模组的高精度仿真和封装集成核心技术。

射频前端芯片作为无线通信设备的核心器件，负责保障信号的发射和接收。公司产品系列覆盖2G、3G、4G、3GHz以下的5G重耕频段、3GHz~6GHz的5G UHB等蜂窝通信频段和Wi-Fi通信等，可为客户提供无线通信射频前端发射模组、接收模组等。

公司的射频前端产品应用于三星、vivo、小米、OPPO、荣耀等国内外智能手机品牌机型，并进入华勤通讯和龙旗科技等一线移动终端设备ODM厂商和移远通信、广和通、日海智能等头部无线通信模组厂商。

2、主要产品和业务情况

报告期内，公司对外销售的主要射频前端模组产品为5G模组和4G模组。随着射频前端支持的通信频段不断增加、通信频率不断上升，射频前端的复杂度和可靠性的要求不断提升，射频前端芯片逐渐从分立器件走向集成化模组，从低集成模组向高集成模组演进。公司基于自主设计的核心射频前端芯片集成其他元器件形成射频前端模组并对外销售。

（1）射频前端的基本构成和功能简介

通讯系统中，射频前端是无线通信设备的核心部件，负责天线和射频收发机之间的射频信号放大、滤波、频段选择等处理，以满足通信系统对无线电波发射和接收的需求。

按照功能，射频前端可分为发射链路（TX）和接收链路（RX）。在发射链路中，数字信号通过调制解调器（Modem）转换成易于传输的连续模拟信号，随后收发器（Transceiver）将模拟信号调制为不易受干扰的射频信号，进入射频前端进行射频信号的功率放大、滤波、开关切换等信号处理，最后通过天线将信号对外发射。接收链路则由天线接收到空间中传输的射频信号，通过射频前端对用户需要的频率和信道进行选择，对接收到的射频信号进行滤波和放大，最后输入收发器和调制解调器得到数字信号。

按照组成器件，射频前端可分为功率放大器（PA）、低噪声放大器（LNA）、滤波器（Filter）、射频开关（Switch）。功率放大器负责发射通道的射频信号放大；低噪声放大器负责接收通道中的小信号放大；滤波器负责发射及接收信号的滤波，去除非信号频率的杂波信号；射频开关负责收发以及不同频率通道之间的切换。

（2）公司主要产品类型及主要情况

报告期内，公司在售产品型号众多，主要产品类型及主要情况如下：

①5G UHB频段系列产品

5G UHB频段系列产品支持3GHz~6GHz的频段范围，更高的频率有利于支持更大的通信带宽，从而获得更快的通信速度。该系列产品主要包括：L-PAMiF发射模组和L-FEM接收模组。

L-PAMiF发射模组内部集成PA、LNA、Switch、Filter等元件。该模组将Sub-6GHz频段的n77/n78/n79的射频发射和接收通路集成在一起，是5G蜂窝通信的核心器件之一。为满足不同市场和客户需求，公司开发有1T2R和1T1R等多种形态产品。2025年，公司发布了新一代n77单频L-PAMiF产品，凭借优异的性能表现收获客户端良好反馈。同时，公司紧跟市场需求和技术演进趋势，持续优化升级新一代高集成、高性能n77单频和n77/n79双频 L-PAMiF产品，为客户提供更具市场竞争力的5G UHB频段射频前端解决方案，公司5G UHB频段L-PAMiF模组已在三星自研体系规模商用，进一步夯实深度合作基础。

L-FEM接收模组内部集成LNA、Switch、Filter等器件，将天线接收到的微弱信号放大，达到更好的接收信号效果。该模组提供单频1R、单频2R和双频2R等多种产品形态，以满足不同需求。公司开发的L-FEM模组已大规模应用于智能手机和物联网设备，并凭借其优异的性能和稳定性，在客户端赢得了认可。

②5G重耕频段系列产品

5G重耕频段主要集中于3GHz以下的频率范围，通信频段覆盖663MHz ~2690MHz。该频段重耕4G LTE通信频段，其通信频率与4G共频段，并支持5G通信协议。公司针对5G重耕频段推出了L-PAMiD高集成模组、5G MMMB PA分立模组和接收模组。

L-PAMiD模组内部集成PA、LNA、Switch、Filter等元件，将Sub-3GHz的射频发射和接收功能封装进一颗芯片模组。公司基于多年的技术积累，以及对射频系统的理解，将多种元件集成在一起并有效避免了频段间干扰。公司基本与国际厂商同步推出Phase8L方案的全集成L-PAMiD产品，支持Sub-3GHz下2G/3G/ 4G/5G 主流频段的发射和接收，2025年该产品已在头部品牌客户高端旗舰机型规模量产，既充分验证了公司产品的卓越性能与品质可靠性，也进一步夯实了公司在射频前端市场的核心竞争优势。

5G MMMB PA模组内部集成PA和Switch，除了常规MMMB PA模组外，公司推出了可以在3.4V低压下输出PC2高功率的低压MMMB PA模组，满足大带宽和高线性要求，在关键性能参数上表现良好，具备较强的竞争力。2025年，公司发布了更小尺寸、更高功率、更高性能5G MMMB PA模组，并在头部品牌客户量产出货。同时，公司发布了高性能的LNA Bank接收模组产品，内部集成LNA、开关及滤波器等元器件。

③4G频段系列产品

随着通信制式从4G向5G演进，4G智能手机市场逐渐成为长尾市场，而4G Cat.1物联网市场则处于快速扩容期。公司持续关注行业发展趋势与市场结构变动，深耕4G射频前端产品赛道，筑牢存量市场业务。

自成立以来，公司专注于4G多频多模功率放大器模组（MMMB PA模组）的研发，并成功实现可重构功率放大器模组的商用化，已推出多款4G LTE可重构射频前端产品，支持4G LTE全频段，通过可重构技术可以在TD-SCDMA/WCDMA/CDMA2000/TD-LTE/FDD-LTE多个模式和频段下实现通路复用，这些产品凭借高集成度和优越性能，获得了客户的广泛认可。目前，公司紧贴市场需求变化，持续迭代升级4G MMMB PA模组，通过技术创新与工艺优化，陆续推出更高性能和更具性价比的产品。

④其他系列产品

为了更快地适应射频前端市场环境变化，保持市场竞争力，公司积极挖掘细分市场潜力，持续开展新技术的研发和新产品的落地。随着数字化时代的发展，Wi-Fi技术在无线通信领域的重要性日益凸显。针对路由器、手机、物联网等市场，公司推出了高性能、低功耗的Wi-Fi FEM模组，适配高通、MTK、Realtek等Wi-Fi系统平台。产品不仅能够满足从路由器的大范围信号覆盖到物联网设备的稳定数据传输，而且针对手机等便携设备的无缝连接等需求，均表现出良好的性能。

2.2主要经营模式

公司的经营模式为集成电路行业常见的Fabless模式。公司充分利用集成电路行业高度专业化分工的产业链特点，主要负责产业链中的设计环节，包括射频前端模组中的核心芯片设计、基板设计和集成化模组设计，并向代工厂委托射频前端芯片的晶圆制造、基板制造和封装测试。在此模式下，公司可以将资源集中在设计研发环节，有利于公司紧密跟随市场变化趋势，不断推出性能优良、竞争力卓越的产品，以满足不断发展的市场需求。

1、研发模式

公司作为Fabless模式的芯片设计公司，其研发活动的核心为对新技术、新产品的研发和设计。公司紧密跟随市场和技术的发展趋势，设计用于支持各类通信制式及各类射频前端方案的芯片及模组产品，以满足复杂的无线通信需求。为了保证质量的基础上开发出符合市场和客户需要的产品，公司已制定多项研发相关内部控制制度，对研发活动的各个环节进行规范化管理，通过各个节点的内部评审降低研发失败的风险。

2、采购及生产模式

公司采用Fabless模式经营，主要负责射频前端模组产品的研发、销售与质量管控，产品的生产则采用委外加工的模式完成。公司根据产品定义设计芯片版图和基板设计方案，委托晶圆代工厂根据芯片版图进行晶圆制造，委托基板代工厂根据基板设计方案进行基板的生产制造，晶圆代工厂、基板代工厂自主采购所需原材料，晶圆制造、基板制造完成后交付给后端封测代工厂，同时公司自主采购滤波器、SMD器件等物料，委托封测代工厂根据集成化模组的设计方案进行系统级封装（SiP）形成模组产品。目前，公司采购的项目主要包括晶圆、基板及相关的封装测试服务，公司的晶圆代工厂、基板代工厂和封测代工厂均为行业知名企业。

3、销售模式

公司的终端客户包括智能手机品牌客户、移动终端设备ODM客户及物联网模组客户等。按照集成电路行业惯例和企业自身特点，公司采用“经销为主、直销为辅”的销售模式。公司与经销商的关系属于买断式销售关系。公司经销商签订销售框架协议，经销商根据其客户需求和自身销售货等因素向公司下达订单，公司根据订单安排出货，按照约定期对账、付款和开票均由公司与经销商双方完成。此外，针对部分终端客户公司采取直销模式，直接对接客户需求并开展业务。

2.3所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

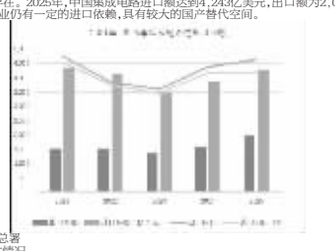
公司主要从事集成电路产品的研发、设计和销售。根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》，公司所属行业为“新一代信息技术产业”。根据《中华人民共和国国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司所处行业为“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”，根据国务院颁布的《关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策的通知》，公司所处的集成电路行业属于鼓励类产业。

（1）集成电路行业的现状

半导体行业是利用分子于导体和绝缘体之间的材料制作器件、电路等衍生出的电子元器件产业，包括集成电路、分立器件、传感器、光电子等细分领域。随着制造工艺和材料体系的不断演进，半导体已成为现代信息社会的基石，广泛应用于各行各业，是实现智能化、电气化的重要支撑力量。据世界半导体贸易统计组织（WSTS）统计，2025年全球半导体市场规模达到7,956亿美元，同比增长26.2%，预计2026年市场规模将继续扩大。近年来，中国的半导体行业已经取得快速成长，半导体行业也将成为我国深入实施创新驱动发展战略的重要部分，为全面建设社会主义现代化国家、实现第二个百年奋斗目标贡献力量。

公司所处集成电路设计行业位于半导体产业链上游，属于技术密集型产业，对技术研发实力要求极高，具有技术门槛高、细分门类多等特点。受益于消费电子市场蓬勃发展，集成电路行业总体呈现上升趋势。在政策支持和市场需求的推动下，中国集成电路产业正加速向高端化、自主化发展。

近年来，我国集成电路市场总体规模持续增长。国家统计局公布的数据显示，2025年中国的集成电路产量为4,843亿块，同比增长10.9%。国内集成电路产业自给率不断提升，但是需求和供给之间仍存在不平衡。如下表所示，我国对集成电路的进口金额和出口金额贸易逆差一直存在。2025年，中国集成电路进口额达到4,243亿美元，出口额为2,019亿美元，贸易逆差高达2,224亿美元。中国半导体产业仍有一定的进口依赖，具有较大的国产替代空间。



图表数据来源：中国海关总署

（2）射频前端行业的基本情况

射频前端芯片属于集成电路中的模拟芯片，主要负责处理高频射频模拟信号，是模拟芯片领域进入门槛较高、设计难度较大的细分领域，功率放大器（PA）芯片作为射频前端核心组件，直接决定无线通信信号强度、稳定性与设备功耗，对终端用户使用体验影响突出，是射频前端领域的关键环节。

根据Yole Group在2025年发布的报告预测，射频设备市场正稳步增长，市场规模预计从2024年的510亿美元提升至2030年的710亿美元，这一增长主要源于各射频技术领域对高性能、集成化、可扩展射频解决方案的需求持续攀升。5G及未来6G通信技术推动移动终端对集成化射频前端的需求，要求将功率放大器、滤波器及射频开关等核心器件高度整合。一方面，智能手机等无线终端设备的市场需求是射频前端市场增长的核心驱动力。随着5G技术的渗透率将持续提升。此外，物联网、智能家居、车联网等新兴领域的快速发展，也为射频前端市场带来了新的增长机遇。另一方面，从2G到5G的通信制式演进，对射频前端器件提出了更高的技术要求。智能手机需要同时兼容2G、3G、4G和5G网络，这不仅增加了射频前端器件的用量，也提升了其技术难度和产品价值，从而推动了射频前端市场规模的进一步扩大。射频前端芯片在无线通信设备中扮演着不可或缺的角色，其市场规模的增长前景广阔，同时也面临着更高的技术挑战和更激烈的市场竞争。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

从通信技术的发展历程来看，射频前端市场主要由国际厂商占据领导地位，其技术实力雄厚，产品定义能力强，占据了射频前端领域的大部分市场份额，主要厂商包括Skyworks（思佳讯）、Qorvo（威讯）、Broadcom（博通）、Qualcomm（高通）和Murata（村田）等。

自2011年成立以来，公司专注于射频前端芯片领域，经过多年的技术积累，逐步崭研发投入转化为实际的经营成果，并形成了多项自主知识产权的核心技术。公司自主研发的“多频多模移动终端可重构射频芯片关键技术与产业化应用”项目曾获得中国通信学会科学技术一等奖。在5G发展周期与国产替代的大背景下，公司凭借长期的技术积累和前瞻性的技术研发，持续加强以射频功率放大器为核心的完整射频前端解决方案布局。

在5G通信市场，公司持续加大研发投入，紧跟技术发展趋势，成功推出了一系列高集成度射频前端模组产品。2024年，公司基本与国际头部厂商同步推出Phase8L低中高频段全集成的L-PAMiD产品，丰富了公司射频前端模组的产品线，扩大了市场覆盖范围，也彰显了公司在高端射频模组领域的技术突破能力，2025年该产品已在头部品牌客户高端旗舰机型规模量产。在5G UHB频段L-PAMiF模组方面，公司不断完善单频、双频的L-PAMiF模组系列形态布局，并在高集成度、小尺寸、高性能和高性价比等多个维度上持续优化，继续保持市场竞争力。在4G手机和物联网市场，面对日益激烈的竞争，公司利用自主可重构技术优势，开发更高性能、更高性价比的射频产品，满足客户的多样化需求。同时，公司积极拓展产品线，布局Wi-Fi领域，相关产品持续迭代中。

公司的射频前端模组产品以高集成度、高性价比、高可靠性，赢得客户的广泛认可，市场知名度不断提升，各系列产品在主要客户中的市场份额逐步扩大。2025年，公司新一代小尺寸高功率MMMB PA、5G UHB频段L-PAMiF模组均已在三星自研体系规模商用，进一步夯实深度合作基础。目前，公司的射频前端模组已经在三星、vivo、小米、OPPO、荣耀等智能手机机型中大规模量产，并进入华勤通讯、龙旗科技等一线移动终端设备ODM厂商的供应链。此外，公司还积极布局物联网领域，持续保持与移远通信、广和通、日海智能等头部无线通信模组厂商的深度合作。

基于长期的经验积累和前瞻的技术研发，公司充分运用核心技术，依托日益优质的客户结构，公司能够准确把握国内射频前端领域客户需求及技术趋势，及时推出和迭代升级产品，已具备较强的竞争优势。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

公司所处的射频前端行业主要下游应用为智能手机、物联网模组等需要使用蜂窝移动通信联网的消费电子行业。公司紧密关注蜂窝移动通信技术和射频前端下游行业的发展，及时满足市场对新技术、新应用的需求。

（1）从5G到5G-Advanced对射频前端芯片设计提出更多技术挑战

全球5G手机渗透率不断扩大，通信架构的复杂化对射频前端芯片提出了更加严苛的要求。随着3GPP冻结了第一个5G-Advanced标准版本的Release18标准，移动通信向更高性能迈进，射频前端芯片设计面临多维度的技术挑战。首先，5G-Advanced通信要求PA提供更高的功率和效率，这大大提升了芯片的设计难度；其次，射频前端需要同时兼容更多的通信线路，器件数量也随之增加。在有限的芯片面积下，更高的集成度成为必然要求，这对射频前端模组的设计提出更高的需求。5G通信技术的演进为射频前端芯片设计带来较大挑战，射频前端厂商必须持续加大技术预研，积累设计和生产经验，快速推出性能优良、满足更高通信需求的射频前端芯片，才能在与国际厂商的竞争中取得一席之地。

（2）射频前端高集成模组成为国产替代下一个主要产品形态

为满足5G通信需求，射频前端方案相比4G更加复杂。更多的频段需要更多的射频通路，更高的射频要求需要更多的LNA、开关等器件；更复杂的频段组合要求更复杂的射频架构，导致5G的射频器件数量对比4G快速增加。与此同时，AI应用需求导致SoC面积增加、摄像头数量增加、电池容量增大、折叠屏设计等新功能需求，进一步挤压了手机结构上留给射频前端芯片的空间。因此，对小型化、功能齐全的高集成射频前端模组的需求显著增加。

在射频前端模组化趋势下，一方面要求射频前端公司拥有较强的芯片设计能力，不仅要考虑在有限的芯片尺寸下设计PA、LNA、Filter、Switch等器件，而且要确保在拥挤的空间内各种射频信号不会互相干扰，尽可能在覆盖各类型产品的情况下提升模组的一致性和可靠性，提高开发效率；另一方面，射频前端集成度的提升，要求射频前端公司具备较强的集成化模组设计能力。通过优化器件布局，提高集成度和良率，从而提升射频前端的整体性能。同时，射频前端公司还应具备良好的SiP封装工艺积累，尤其是采用有利于提高射频前端模组性能和集成度的倒装（Flip chip）封装工艺，这对射频前端厂商的芯片设计与封装设计结合能力提出了考验。因此，公司一方面加大在芯片高精度仿真和验证的投入，另一方面积极和封装厂合作开发更高集成度、更高信号隔离度的封装技术。

随着射频前端行业的发展，国外一线厂商利用先发优势，占据了高集成化射频前端模组的主要市场份额。然而，随着分立器件的国产替代进一步扩大，公司积累了丰富的器件和模组化的技术经验，持续发力高集成化的射频前端模组研发。2024年，公司基本与国际厂商同步推出Phase8L 方案的全集成L-PAMiD产品，支持Sub-3GHz下2G/3G/4G/5G主流频段的发射和接收，2025年该产品已在头部品牌客户高端旗舰机型规模量产。

（3）5G RedCap大规模商用在即，推动5G物联网市场规模起量

5G RedCap作为3GPP R17引入的轻量化设计精简终端设备的复杂度，优化成本结构，同时提供中高速率连接能力，适用于工业无线传感器、视频监控、可穿戴设备等场景。相比传统5G eMBB，RedCap通过缩减带宽、减少天线数量、降低调制阶数等方式，显著降低了功耗和成本。

2023年，工业和信息化部办公厅发布《关于推进5G轻量化（RedCap）技术演进和应用创新发展的通知》，从政策层面为5G RedCap产业的技术迭代、场景落地指明发展方向，推动行业迈入规范化、规模化发展快车道。随着RedCap技术的不断迭代升级，进一步拓宽了其在物联网领域的应用场景，产业发展动能持续释放。预计到2026年，5G RedCap网络部署、网络覆盖范围持续扩大，适配智能穿戴设备、智慧汽车等大众消费类场景的通信需求，筑牢产业规模化落地的网络根基，截至2025年末，全国具备5G RedCap接入能力的基站数达206.4万个，占5G基站总量的42.7%。同时，行业内RedCap应用场景持续创新拓展，各类新产品、新业态、新模式加速涌现，应用规模快速攀升，市场活力得到充分激发，5G物联网市场迎来规模化发展机遇。2025年，公司推出的RedCap射频前端完整解决方案，已经在头部物联网客户规模量产，同时正在积极布局下一代产品，持续打磨产品竞争力，助力公司未来在5G物联网市场占据先发优势。

（4）车联网、卫星通信成为新的应用增长点

当前，车联网、卫星通信快速发展，逐步成为蜂窝射频前端行业全新的应用增长点与业务增量引擎，为行业发展开辟了更广阔的市场空间。随着智能网联汽车产业高速发展，高阶智能驾驶、车路协同、车载高速通信等场景逐步普及，车载通信终端对射频前端器件的性能，稳定性，可靠性提出了严苛要求，既需兼容多频段通信信号，又要适配车载复杂工况环境，市场需求呈现增长态势，带动车载无线通信模组需求大幅攀升，成为蜂窝射频前端行业的重要增量支点。公司部分产品已经通过车规可靠性的测试，获得AEC-Q104车规认证，并在客户端推广。卫星通信领域，手机直连卫星功能逐步兴起，相关通信需求从旗舰机型持续下探至中高端机型，消费端普及趋势初显，新增的卫星通信系统为射频前端行业带来了全新的市场机遇。公司密切关注市场动态，凭借深厚的技术积累和研发能力，加快推出适合新市场的射频产品，以满足不断变化的客户需求。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	1,933,519,561.83	2,211,677,058.74	-12.58	2,392,902,856.63
归属于上市公司股东的净资产	1,640,567,423.65	1,806,309,190.76	-9.18	2,171,731,711.29
营业收入	807,273,689.37	523,986,948.28	54.06	552,024,362.34
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	807,273,689.37	523,986,948.28	54.06	552,024,362.34
利润总额	-228,957,674.76	-379,459,712.62	不适用	-407,436,074.61
归属于上市公司股东的净利润	-229,014,946.68	-438,416,962.82	不适用	-408,506,484.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-319,734,043.63	-473,633,121.18	不适用	-450,318,507.07
经营活动产生的现金流量净额	-320,832,568.75	-295,049,750.59	不适用	-217,684,660.28
加权平均净资产收益率(%)	-13.29	-22.05	增加8.76个百分点	-21.68
基本每股收益(元/股)	-0.49	-0.96	不适用	-0.95
稀释每股收益(元/股)	-0.49	-0.96	不适用	-0.95
研发投入占营业收入的比例(%)	27.77	47.41	减少19.63个百分点	58.84

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	136,864,396.13	217,651,950.99	213,328,498.48	239,428,844.77
归属于上市公司股东的净利润	3,567,106.59	-68,845,493.33	-57,111,145.12	-106,625,414.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-60,674,498.60	-76,681,396.76	-68,333,660.50	-114,044,487.77
经营活动产生的现金流量净额	-56,223,289.45	-180,171,942.11	-15,073,124.41	-70,364,212.78

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	17,153
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	16,352
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数（户）	0

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
李阳	1,650,000	36,431,200	7.80	36,431,200	无	0	境内自然人
华芯投资管理有限责任公司－国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	0	26,028,448	5.58	0	无	0	国有法人
郭艳辉	876,000	20,579,880	4.41	20,579,880	无	0	境内自然人
珠海横琴智古企业管理合伙企业（有限合伙）	0	15,802,000	3.38	15,802,000	无	0	其他
珠海横琴智来企业管理合伙企业（有限合伙）	0	14,230,000	3.05	14,230,000	无	0	其他
珠海横琴智往企业管理合伙企业（有限合伙）	0	13,320,000	2.85	13,320,000	无	0	其他
广州慧智慧芯企业管理合伙企业（有限合伙）	0	12,963,084	2.78	12,963,084	无	0	其他
广东粤湛企业管理合伙企业（有限合伙）	0	10,784,740	2.31	0	无	0	其他
Smartermicro Star Hong Kong Limited	-496,234	9,063,766	1.94	0	无	0	境外法人
GZPA Holding Limited	-6,935,049	8,471,284	1.81	0	无	0	境外法人
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，李阳、郭艳辉为一致行动关系；李阳系横琴智古的执行事务合伙人；郭艳辉系慧智慧芯、横琴智往、横琴智来的执行事务合伙人，公司未知无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用					

存托凭证持有人情况

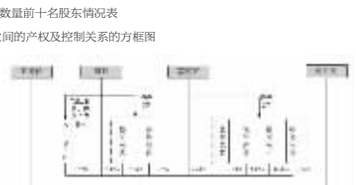
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入807,727.37万元，较上年同期增长54.06%，实现公司归属于上市公司股东的净利润为-22,901.49万元，净亏损较上年同期减少947.76%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-31,973.40万元，净亏损较上年同期减少32.49%。具体经营情况分析详见本节“一、经营情况讨论与分析”相关内容。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:688512 证券简称:慧智微 公告编号:2026-020

广州慧智微电子股份有限公司关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2026年5月13日（星期三）下午13:00-14:00
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
- 会议召开方式：上证路演中心网络互动
- 投资者可于2026年5月6日（星期三）至5月12日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱db@smartermicro.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

广州慧智微电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月29日发布公司2025年年度报告和2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度及2026年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于2026年5月13日（星期三）下午13:00-14:00举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年度及2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年5月13日（星期三）下午13:00-14:00

（二）会议召开地点：上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理：李阳

董事会秘书、财务总监：徐斌

独立董事：洪波、李斌

如有特殊情况，参会人员可能进行调整。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年5月13日下午13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年5月6日（星期三）至5月12日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallCha），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱db@smartermicro.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：董事会办公室

电话：020-82258480

邮箱：db@smartermicro.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

广州慧智微电子股份有限公司

董事会

2026年4月29日

证券代码:688512 证券简称:慧智微 公告编号:2026-019

广州慧智微电子股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》及广州慧智微电子股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和2025年度的经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的相关资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。

2025年度，公司确认信用减值损失和资产减值损失金额共计3,739.70万元，具体如下：

单位：万元

项目	2025年度计提金额	备注
信用减值损失	259.07	应收账款、其他应收款及应收票据坏账损失
资产减值损失	3,480.63	存货跌价损失
合计	3,739.70	

二、计提资产减值准备事项的具体说明

（一）信用减值损失

本次计提信用减值损失主要为应收账款、其他应收款及应收票据坏账损失。在资产负债表日，公司依据相关会计政策和会计估计测算表明其中发生了减值的，按规定计提减值准备。公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。经测试，2025年度计提信用减值损失金额共计259.07万元。

（二）资产减值损失

本次计提资产减值损失主要为存货跌价损失。资产负债表日，公司采用存货成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。经测试，2025年度计提存货跌价损失金额共计3,480.63万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

报告期内，公司计提信用减值损失和资产减值损失共计3,739.70万元，导致2025年度合并报表税前利润减少3,739.70万元。本次计提减值准备等事项是基于谨慎性原则，客观体现了公司资产的实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生重大影响。上述金额已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

四、其他说明

2025年度计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观反映公司截至2025年12月31日的财务状况和2025年度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。

特此公告。

广州慧智微电子股份有限公司

董事会

2026年4月29日

证券代码:688512 证券简称:慧智微 公告编号:2026-018

广州慧智微电子股份有限公司关于公司续聘2026年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

广州慧智微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2026年度外部审计机构。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

| 事务所名称 | 天